

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2023-025

深圳市力合微电子股份有限公司
关于高集成度智能家居高速电力线通信（PLC）
SoC 芯片流片成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）高集成度智能家居高速电力线通信（PLC）SoC 芯片已流片成功。该芯片作为公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一，目前已成功取得阶段性成果。公司将充分发挥自身在电力线通信技术领域及芯片研发的优势，进一步提升公司在智能家居、全屋智能乃至数字家庭产业中的竞争实力和市场地位，增强公司的可持续发展能力。

高集成度智能家居高速电力线通信（PLC）SoC 芯片应用场景包括智能照明、智能家电、全屋智能在内的智能家居系统各类受控端设备和开关面板应用。优势包括：1、该芯片具有高性能高速电力线通信功能及支持 PLC MESH 组网；2、该芯片集成了高性能 32 位 CPU，具有丰富的芯片资源，更利于客户进行二次应用开发；3、具有丰富的接口和外设，可满足不同品类智能设备的应用需求；特别是针对智能照明需求，提供高精度的多路 PWM 输出，可更好满足智能照明调光和调色的精细化要求；4、采用更高端芯片工艺设计，芯片成本和功耗更有竞争力，可有效推动智能家居批量推广；5、优化提升了 PLC 的抗脉冲干扰能力，在智能家居应用场景下 PLC 通信的稳定性和可靠性更高。

高集成度智能家居高速电力线通信（PLC）SoC 芯片流片成功后，仍需经过客户验证，未来的市场需求、市场拓展及市场竞争具有不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日